

Plaskon ALP-2 (188)

Ероху; Epoxide

Cookson Electronics - Semiconductor Products

Описание материалов:

This material is an epoxy encapsulant for high productivity packaging of very thin, stress-sensitive devices such as TSSOP's. Performance attributes are intended to meet or exceed JEDEC Level 1 for all packages and have no or limited post-mold cure, fast cure cycle times tailored to specific applications and excellent adhesion to Cu and Pd-Ni leadframes.

| Главная Информация | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Полупроводникового Низкая гигроскопичность Лазерная маркировка Цикл быстрого формования Ускоренная Настройка Хорошая производительность формования | | |
| Используется | Тонкостенная упаковка | | |
| Формы | Жидкость | | |
| Метод обработки | Литье из смолы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.92 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Флекторный модуль | | | ASTM D790 |
| 22°C | 2.26 | MPa | ASTM D790 |
| 260°C | 0.0735 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | | | ASTM D790 |
| 22°C | 0.0127 | MPa | ASTM D790 |
| 260°C | 6.86E-4 | MPa | ASTM D790 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура перехода стекла | 111 | °C | ASTM E1356 |
| CLTE-Поток | 9.0E-6 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| Теплопроводность | 1.0 | W/m/K | ASTM C177 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Сопротивление громкости | 1.0E+12 | ohms-cm | ASTM D257 |
| Диэлектрическая прочность | 55 | kV/mm | ASTM D149 |
| Диэлектрическая постоянная (1 MHz) | 3.80 | | ASTM D150 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Огнестойкость (3.18 mm) | V-0 | | UL 94 |

Дополнительная информация

Recommended Storage Temperature: <5°C Life @ 5°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 6 months Life @ 22°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 2 days Life @ 35°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 0.5 days Spiral Flow, 175°C, 1000 psi: 100 cm Shimadzu Viscosity, 175°C, 1000 psi: 50 poise Ram Follower Gel Time, 175°C, 1000 psi: 16 sec Ash Content: 86 % Hydrolyzable Halides: <1 ppm Moisture Absorption, 85°C/85%RH, 168 hrs: 0.25% Cull Hot Hardness, Shore D: 70 Volume Resistivity, 22°C: 1e12 ohm-cm Volume Resistivity, 150°C: 1e9 ohm-cm All test specimens are transfer molded and post cured for 4 hours at 175°C

Linear Thermal Expansion, Alpha 1: 9 cm⁻⁶/cm/°C

Linear Thermal Expansion, Alpha 2: 39 cm⁻⁶/cm/°C

Инструкции по впрыску

Resin Transfer Molding:

Molding Temperature: 170 to 185°C

Molding Pressure: 750 to 1250 psi

In Mold Cure Time: 70 to 120 sec

Post Mold Cure Time, 175°C: 0 to 4 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

